

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	兴全基金、国寿安保基金、中信保诚基金、长信基金、广发证券、中金公司、申万电子等多家机构
时间	2025年06月06日下午
地点	上海陆家嘴香格里拉酒店
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：赵奇 财务负责人：王韦 董事会秘书：张毅 研发资深总监：陆珏 芯联动力董事长：袁锋
投资者关系活动主要内容介绍	芯联集成始终聚焦硅基及碳化硅功率半导体、MEMS传感器及BCD等核心领域，为新能源汽车、工业控制及智能家电提供完整的系统代工解决方案。 在AI技术爆发式发展的浪潮中，芯联集成已深度布局AI数据中心、AI手机及服务器市场：（1）AI芯片代工：公司电源管理芯片获AI数据中心合作伙伴重大定点，赋能算力基础设施升级；（2）机器人产业链：结合MEMS传感器技术优势，公司正切入服务机器人、工业自动化等场景，满足高精度传感与控制需求。芯联集成的系统化代工与智能化产线，将为这一增长提供核心硬件支撑。 1、芯联集成为什么将AI作为公司第四大战略市场？

	2018年-2024年，公司抓住了“新能源”产业大发展的机遇；面向未来，在智能化或AI产业领域的深耕，将直接关系公司未来成就的广度和高度。 首先，AI技术发展带来巨大的芯片需求。比如，AI大模型对算力的需求，带动算力服务器井喷式增长，除了算力、存力芯片外，对高功率密度、高转换效率、高稳定性的服务器电源管理系列芯片，也提出更高的要求。在智能辅助驾驶、具身智能等领域，对电源管理和传感器芯片同样有着快速增长的市场需求。 其次，公司具备深厚的技术积累优势。在新能源产业的助推下，芯联集成在功率半导体、模拟IC等领域技术积累深厚，拥有完善一站式系统代工平台，奠定了公司发力AI的坚实基础。在AI服务器电源领域，公司可以提供从一级电源、二级电源，到板上电源管理芯片组的完整解决方案，具有较大技术优势。 第三，公司在AI领域已经实现产品突破，量产项目成果丰硕。180nm BCD电源管理芯片已经实现大规模量产；集成了Dr MOS的55nm BCD平台也已完成客户验证，正在进入量产。机器人灵巧手的动作驱动芯片、高级辅助驾驶ADAS里面的激光雷达芯片、惯性导航芯片、压力传感器芯片等，均已实现量产。 基于以上，2025年公司把AI从原来的工控市场中单列出来，独立作为公司第四大核心市场方向，不仅从AI产业所需芯片的研发生产，也从AI深度参与公司运营上，全面拥抱AI时代的到来，进一步拓展公司成长的空间。 2、芯联集成如何规划和布局AI与机器人领域？ 芯联集成通过多元化的布局，已深度切入AI服务器电源、人形机器人等热门赛道，同时精准挖掘智能驾驶领域的新增量，打造增长新动能。 在AI服务器、数据中心等应用方向，已经发布面向数据中心服务器的55nm高效率电源管理芯片平台技术，客户产品验证完成并进入量产，全面推动产品导入和市场渗透。同时，服务器电源相关的全系列功率产品从中低压的SGT到高压的超结和SiC平台都已成熟，相关产品逐步抢占市场份额。 在机器人方向，芯联集成在AI末端应用上提供高性能功率芯片和多品种智能传感器芯片，公司MEMS传感器及功率类芯片代工产品成功量产。公司将紧跟行业发展趋势，不断创新，并持续扩大为机器人新系统提供电源、电驱、传感等各种芯片。
--	---

	3、芯联集成为什么选择系统代工？ 第一，公司选择系统代工是市场与客户不断推动和选择的结果。整个半导体产业链从上游到下游，各环节不断精简、效率不断提升，整个链条变得更短、更高效。 第二，系统代工融合了传统工艺代工和IDM模式各自的优势。一方面，公司的系统代工模式继承了Foundry的核心精神—开放平台；另一方面，又突破了传统Foundry的局限，能够实现产业链上下游更紧密的协同设计、协同制造。从前端的设计服务，到后端的封装、测试，甚至系统级的整合，公司都能提供更顺畅、更高效的配合支持。系统代工的商业模式使公司在开放平台的基础上，打通了产业链的关键环节，提供更深层次、更一体化的服务能力。 第三，系统代工是一种高度灵活的“全场景”解决方案。公司可以为不同的客户、不同的应用场景需求，打造一个丰富的“全场景货架”。客户可以根据其需求，分层、分段自由地选择、组合，每一位客户都能在这个平台上，找到最适合的路径和解决方案。 系统代工是在新能源革命和市场需求双重驱动下应运而生的创新模式，它融合开放与协同，提供全场景的灵活服务，旨在赋能客户，共同推动产业链的高效发展。 4、芯联集成为什么能够在各细分领域做到领先？ 第一，芯联集成敢于选择“难而正确”的赛道并长期深耕，将“用芯片管理能源和用芯片感知世界”作为战略核心。（1）用芯片管理能源：公司始终全力投身于功率半导体领域。新能源及人工智能的爆发对高效、可靠、智能的功率转换和管理芯片提出了更新、更高的要求，公司聚焦于IGBT、SiC MOSFET器件及模组，致力于解决能源转换效率这个关键难题。（2）用芯片感知世界：是MEMS传感器技术的使命。从汽车自动驾驶，到工业自动化、消费电子，乃至未来的人形机器人，都需要精准、微型、低功耗的MEMS传感器，这些都是公司的强项所在。以上两方面技术门槛高、投入大，但是支撑公司未来智能化、绿色化发展的底层硬科技，是真正有价值、有长远生命力的方向。 第二，芯联集成重视构建一个系统化、可持续的研发创新体系。除了招揽顶尖人才，公司（1）在研发上有明确的技术路线图，确保研发资源高效聚焦在战略方向上。同时，建立了“应用-设计-工艺”的闭环学习路径。这个体系，就是公司技术创新的“发动机”。（2）在核心研发团队上，公司强调每个工程师的学习，要求其每年有非常明显的进度；不断把工程师培养成一个领域、甚至多领域的核心人才。公
--	--

	司近千名员工通过员工持股、期权激励、战略配售以及二类限制性股票等方式直接/间接和公司的股权关联，已涵盖了公司主要的技术人员和管理人员。 第三，与终端客户深度合作，从“供应商”到“共创者”。芯联集成与终端客户保持着深度的合作关系，主动深入客户的研发前端，与客户共同探讨下一代产品的需求和痛点。这种合作方式，使公司从单纯的“交付产品”，转变为并肩作战的“共创者”。公司与客户共享前端需求，共同定义产品规格，甚至联合开发定制化的解决方案。这种深度捆绑，确保了公司的技术研发始终紧贴市场脉搏，解决客户最实际、最贴切的需求。 半导体是长周期产业，研发投入不仅推动公司保持技术领先，更是公司面向未来的最重要投资。在选定的战略赛道上的不断投入，确保了公司在核心技术上的持续突破和差异化竞争力。
附件清单（如有）	无
日期	2025年6月6日